

# CAの特許収録の流れ

2011年11月

**JAICI**  
化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル  
サービス全般 TEL: 0120-151-462  
E-mail: [customer@jaici.or.jp](mailto:customer@jaici.or.jp)  
ヘルプデスク TEL: 0120-003-462  
E-mail: [support@jaici.or.jp](mailto:support@jaici.or.jp)

## 本日のテーマ

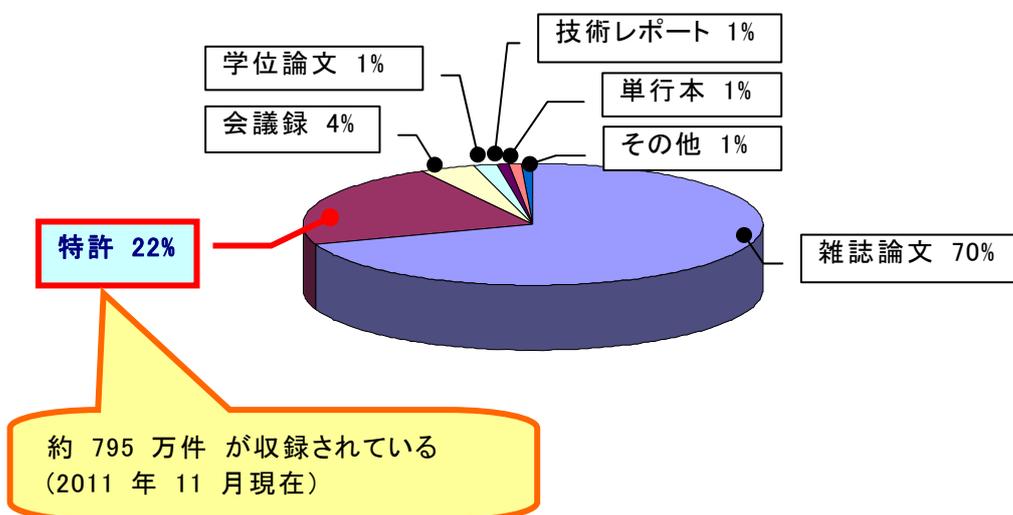
- CAplus/CA ファイルとは
- CAplus/CA ファイルの収録源
- 特許情報の収録基準
  - ✓ 3 段階ルール
  - ✓ 収録までの 3 つのパターン

## CAplus/CA ファイルとは

- 世界中の科学技術分野の学術論文，単行本および特許の情報を収録する文献データベースである。
- CAplus/CA ファイルのレコードには，書誌情報（標題，著者名，雑誌名など），抄録，索引情報が収録されている。

抄録，索引情報はデータベース製作者であるCAS (Chemical Abstracts Service) が作成している

## CAplus/CA ファイルの収録源



## 特許情報の収録基準

- 年代により収録基準が異なる。

年代	収録基準
～ 1980 年	CAS が独自に収集
1981 年 ～ 現在	3 段階の基準を設けて，化学関連分野の特許を決定する

本セミナーでは 1981 年以降の特許収録基準を説明する



## 第一段階：特許発行国および機関による選択

特許発行国（機関）のリスト（\*1）

<http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/patcoverage/patyear.html>

Patent Coverage Home  
 IPC 8 Guaranteed Coverage  
 IPC 8 Selective Coverage  
 Country Codes and Years  
 Kind Codes  
 IPC7 Guaranteed Coverage  
 IPC7 Selective Coverage  
 U.S. NPC

For additional information, see IPC Reform and STN.

Home • Our Expertise • CAS Databases • Caplus • Patent Coverage in CA • Coverage of CA Basic Patents by Year

### Coverage of CA Basic Patents by Year

CAS has covered patents of chemical, biochemical, and chemical engineering interest from 1907 to the present.

This table lists the countries, patent kinds, and years of coverage for the CA basic patents, i.e., patent documents abstracted and indexed by CAS.

Country Code	Kind Code	Publication Type	Publication Years
AP African Regional Industrial Property Organisation	A	Granted Patent	2000-
AR Argentina	A1	Patent Application	1959, 1961, 1964, 2006-
	A2	Divisional Patent Application	1959, 1961, 1964, 2006-
	A3	Additional Patent Application	1959, 1961, 1964, 2006-
	A4	Independent Utility Model Application	1959, 1961, 1964, 2006-
	A6	Additional Utility Model Application	1959, 1961, 1964, 2006-
AT Austria	A1	Oesterreichische Patentanmeldung (With search report)	10/2005-
	A2	Oesterreichische Patentanmeldung (Without search report)	10/2005-
	A4	Oesterreichische Patentanmeldung (Post-grant Application)	10/2005-
	B	Patentschrift (Patent)	1907-
AU Australia	A1	Standard/Petty Application	09/2001-
	A4	Granted OPI Innovation Patent	05/2001-

ベーシック特許の特許種別と収録開始年

収録対象国（機関）のリスト

## 第二段階：特許種別による選択

ベーシック特許・対応特許の収録対象である特許種別のリスト (\*2)

<http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/patcoverage/patkind.html>

▶ IPC 8 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC 8 Selective Coverage  
 ▶ Country Codes and Years  
 ▶ Kind Codes  
 ▶ IPC7 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC7 Selective Coverage  
 ▶ U.S. NPC

For additional information, see IPC Reform and STN.

**収録対象になる特許種別のリスト**

*Patent Kind Codes for CA Basic and Patent Family Members*

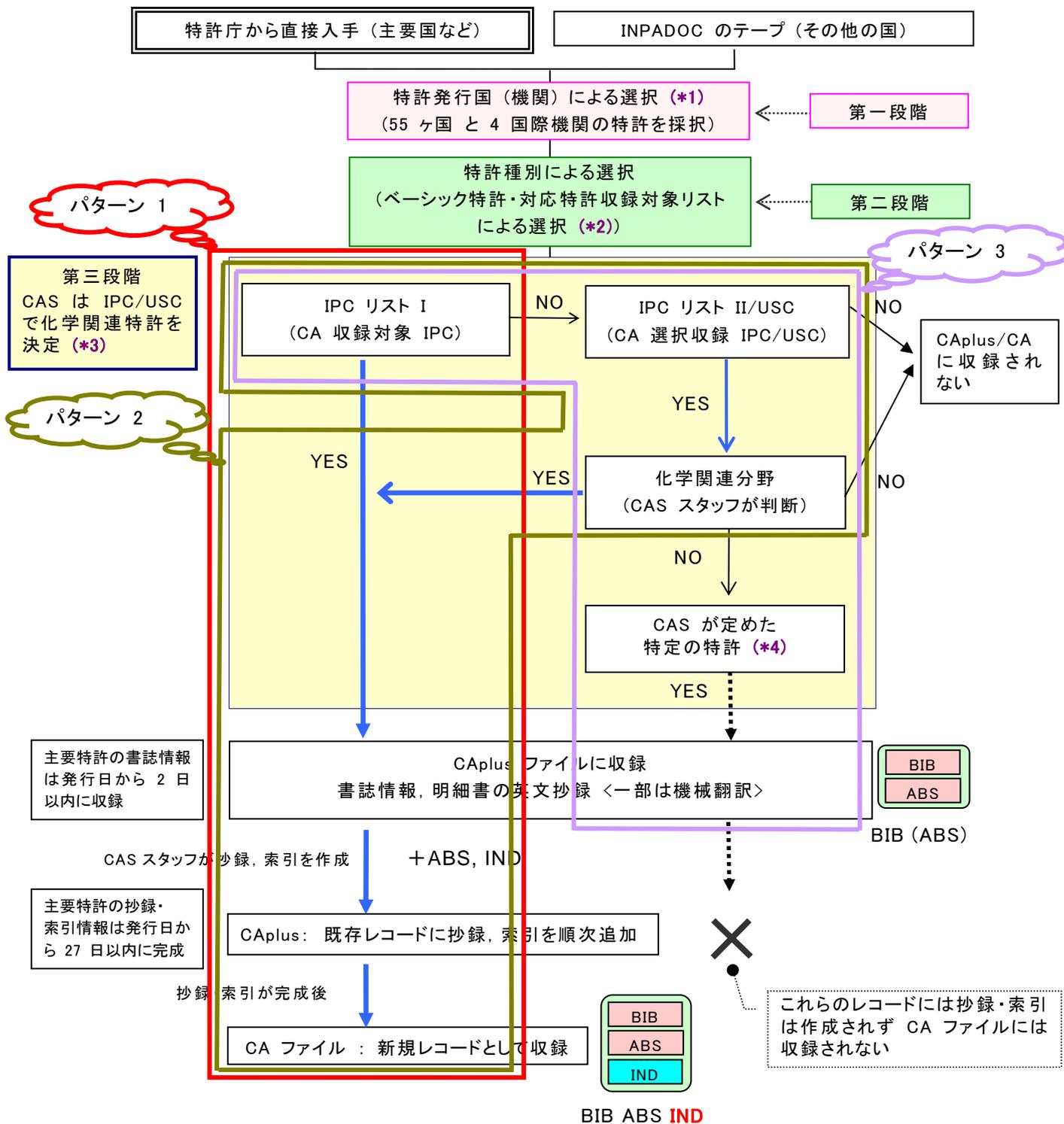
CAS has covered patents of chemical, biochemical, and chemical engineering interest from 1907 to the present.

This table is a list of patent kind codes for the CA basic patents and patent family members for the countries covered by CAS.

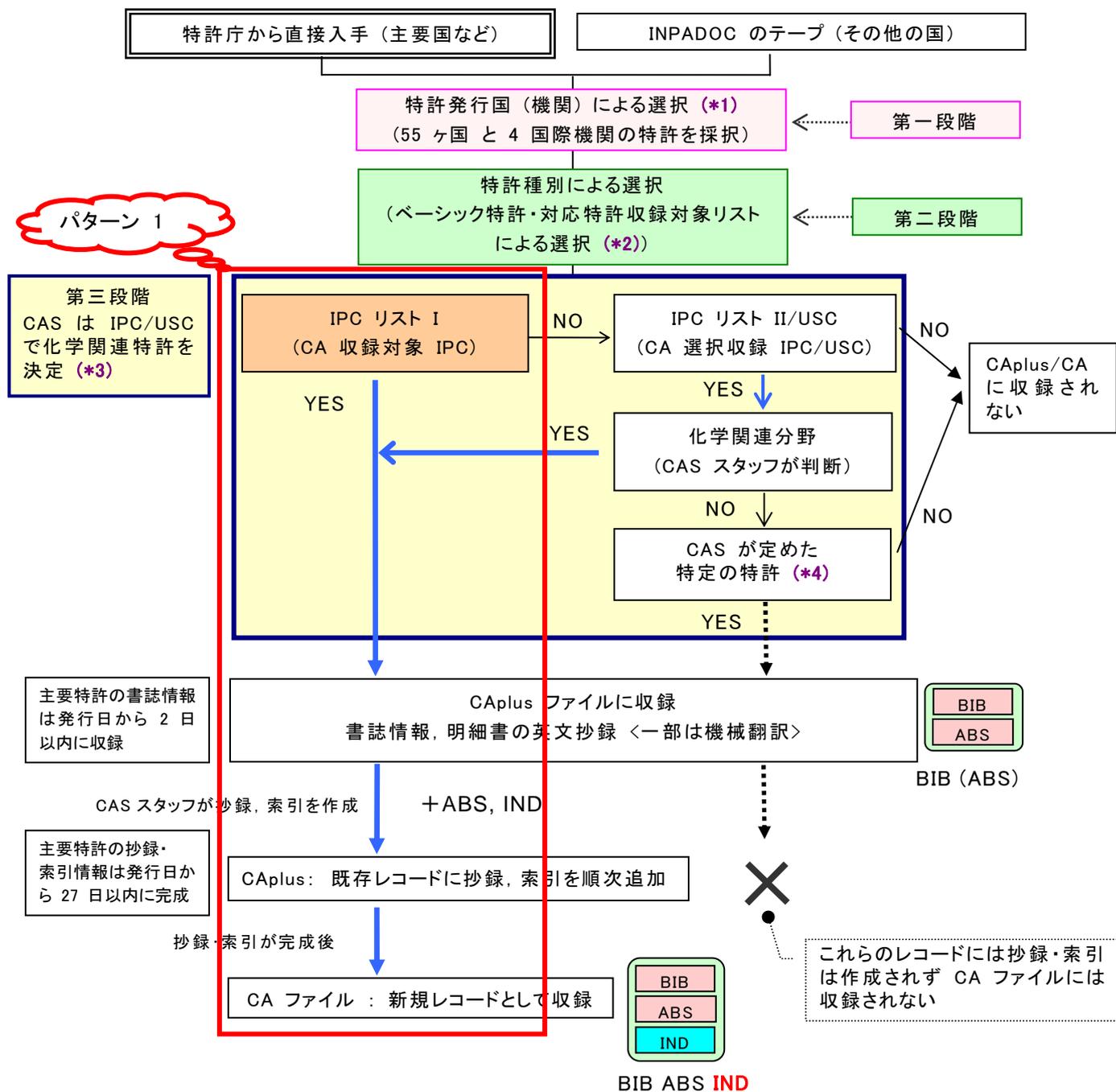
Kind Code List for Patents Covered			
Country Code	Country	Kind Code	Type of Publication or Document Title
AP	African Regional Industrial Property Organization	A	Granted Patent
AR	Argentina	A1	Patent Application
		A2	Divisional Patent Application
		A3	Additional Patent Application
		A4	Independent Utility Model Application
		A6	Additional Utility Model Application
		A	Document Laid Open
AT	Austria	A1	Oesterreichische Patentanmeldung (With search report)
		A2	Oesterreichische Patentanmeldung (Without search report)
		A3	Oesterreichische Patentanmeldung (Search report)
		A4	Oesterreichische Patentanmeldung (Post-Grant Application)
		A9	Korrigierte Patentanmeldungen
		B/B1	Patentschrift
		T	Translation of European Patent Application
		A	OPI (Open to Public Inspection)
AU	Australia	A1	Standard/Petty Application
		A2	Amended Post OPI
		A4	Granted/OPI Innovation Patent
		A5	Pre-Granted/OPI Innovation Patent
		A6	Amended Post Grant OPI
		A9	Correction of an A Level Publication

## 第三段階：特許分類による選別

- 公報に記載されている特許分類により, CAplus/CA ファイルに収録されるまでのフローが異なる。



# 〔パターン 1：公報記載の IPC が IPC List I に含まれている〕



## 例 : JP2011200939

JP 2011-200939 A 2011.10.13																																				
<p>第一段階 日本</p> <p>(19) 日本国特許庁 (JP)</p>	<p>第二段階 公開特許</p> <p>(12) 公開特許公報(A)</p>																																			
(11) 特許出願公開番号 <b>特開2011-200939</b> (P2011-200939A) (43) 公開日 平成23年10月13日 (2011.10.13)																																				
<p>(51) Int. Cl.</p> <table border="1"> <tr><td>B82B</td><td>3/00</td><td>(2006.01)</td></tr> <tr><td>C01B</td><td>31/02</td><td>(2006.01)</td></tr> <tr><td>B82B</td><td>1/00</td><td>(2006.01)</td></tr> <tr><td>H01J</td><td>9/02</td><td>(2006.01)</td></tr> <tr><td>H01J</td><td>1/304</td><td>(2006.01)</td></tr> </table>	B82B	3/00	(2006.01)	C01B	31/02	(2006.01)	B82B	1/00	(2006.01)	H01J	9/02	(2006.01)	H01J	1/304	(2006.01)	<p>F I</p> <table border="1"> <tr><td>B82B</td><td>3/00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C01B</td><td>31/02</td><td>101F</td><td></td></tr> <tr><td>B82B</td><td>1/00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H01J</td><td>9/02</td><td>B</td><td></td></tr> <tr><td>H01J</td><td>1/30</td><td>F</td><td></td></tr> </table> <p>審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 8 頁) 最終頁に続く</p>	B82B	3/00			C01B	31/02	101F		B82B	1/00			H01J	9/02	B		H01J	1/30	F	
B82B	3/00	(2006.01)																																		
C01B	31/02	(2006.01)																																		
B82B	1/00	(2006.01)																																		
H01J	9/02	(2006.01)																																		
H01J	1/304	(2006.01)																																		
B82B	3/00																																			
C01B	31/02	101F																																		
B82B	1/00																																			
H01J	9/02	B																																		
H01J	1/30	F																																		
<p>(21) 出願番号 特願2010-67723 (P2010-67723)          (22) 出願日 平成22年3月24日 (2010.3.24)</p> <p>第三段階 特許分類により化学関連特許かどうかを決定する</p> <p>↓</p> <p>公報記載の IPC が <b>IPC List I</b> に含まれているかどうかを確認する</p>	<p>(71) 出願人 000003193          凸版印刷株式会社          東京都台東区台東1丁目5番1号</p> <p>(72) 発明者 栗原 均          東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内</p> <p>(72) 発明者 蒲生 秀典          東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内</p> <p>Fターム(参考) 4G146 AA11 AD21 AD29 BA13 BA43          BC02 BC44          5C039 MM02</p> <p style="text-align: right;">最終頁に続く</p>																																			
<p>(54) 【発明の名称】 ナノ炭素材料複合基板製造方法およびナノ炭素材料複合基板</p>																																				

## IPC 8 の IPC List I (\*3)

<http://www.cas.org/content/references/patipcguar8>

▶ IPC 8 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC 8 Selective Coverage  
 ▶ Country Codes and Years  
 ▶ Kind Codes  
 ▶ IPC7 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC7 Selective Coverage  
 ▶ U.S. NPC

For additional information, see IPC Reform and STN.

**IPC Reform List I: Guaranteed Coverage**

This list has the IPC codes from the 2006 IPC Reform that are used by CAS for guaranteed coverage.

Class/ Subclass	Subject Matter	Groups Guaranteed Coverage
<b>A: HUMAN NECESSITIES</b>		
A01N	Biocides, pesticides, herbicides, and plant growth regulators	27/00-61/02, 65/02
:		
<b>B: PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING</b>		
B01D	Separation	3/12, 7/02, 9/00-15/42, 53/48-53/72, 53/86, 53/90, 53/94, 59/00-61/04, 61/14-61/16, 61/36-61/44, 61/56-61/58, 65/06-65/08, 71/00-71/82
:		
B82B	Nanostructures: manufacture and treatment	all groups
<b>C: CHEMISTRY; METALLURGY</b>		
C01B	Nonmetallic elements and their compounds	all groups
C01C	Ammonia, cyanogen and their compounds	all groups
:		
<b>H: ELECTRICITY</b>		
H01B	Cables, conductors, insulators and dielectrics	1/00-3/56
H01C	Resistors	7/108-7/118
H01F	Magnetic materials and inductors	1/00-1/01, 1/032-1/44, 10/00, 10/08-10/30
H01G	Capacitors	9/022-9/038, 9/042-9/045
H01J	Electric discharge tubes or discharge lamps	1/142-1/148, 19/062-19/068, 61/14-61/22

B82B 3/00,  
C01B31/02,  
B82B 1/00 は  
**IPC List I に  
含まれている**

H01J 9/02,  
H01J 1/304 は  
IPC List I に  
含まれない

公報記載の IPC が **IPC List I** に一つでも含まれている場合は、**パターン 1** になる  
 → CAplus ファイルに収録され、**必ず索引が付与**される。  
 → CA ファイルにも収録される。

## CAplus ファイルに収録

1. 初めに, CAplus ファイルに書誌情報, 明細書の英文抄録 (一部は機械翻訳) が収録される.
  - ✓ 主要特許の書誌情報は発行日から 2 日以内に収録される.

書誌情報  
(BIB)

AN 2011:1300575 CAPLUS  
 ED Entered STN: 13 Oct 2011  
 TI A nano carbon material composite board method for manufacturing and a nano carbon material composite board [Machine Translation].  
 TIJP ナノ炭素材料複合基板製造方法およびナノ炭素材料複合基板 [原題]  
 IN Kurihara, Hitoshi; Gamo, Hidenori  
 PA Toppan Printing Co., Ltd., Japan  
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 8pp.  
 CODEN: JKXXAF  
 DT Patent  
 LA Japanese  
 CC 76 (Electric Phenomena)  
 FAN. CNT 1

特許発行日 (2011 年 10 月 13 日)  
 当日に書誌情報が収録された

書誌情報  
(STD)

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI JP 2011200939	A	20111013	JP 2010-67723	20100324 <--
PRAI JP 2010-67723		20100324		

CLASS

PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
JP 2011200939	IPC1	B82B0003-00 [I, A]; C01B0031-02 [I, A]; B82B0001-00 [I, A]; H01J0009-02 [N, A]; H01J0001-304 [N, A]; H01J0063-06 [N, A] <--
	FTERM	4G146/AA11; 4G146/AD21; 4G146/AD29; 4G146/BA13; 4G146/BA43; 4G146/BC02; 4G146/BC44; 5C039/MM02; 5C127/AA01; 5C127/AA20; 5C127/BA12; 5C127/BA13; 5C127/BA15; 5C127/BB07; 5C127/BB08; 5C127/BB19; 5C127/CC03; 5C127/DD07; 5C127/DD32; 5C127/DD64; 5C127/EE01; 5C127/EE02; 5C127/EE03; 5C127/EE04; 5C127/EE05; 5C127/EE06; 5C127/EE07; 5C127/EE08; 5C127/EE09; 5C127/EE10; 5C127/EE11; 5C127/EE12; 5C127/EE13; 5C127/EE14; 5C127/EE15; 5C127/EE16; 5C127/EE17; 5C127/EE18; 5C127/EE19; 5C127/EE20; 5C127/EE21; 5C127/EE22; 5C127/EE23; 5C127/EE24; 5C127/EE25; 5C127/EE26; 5C127/EE27; 5C127/EE28; 5C127/EE29; 5C127/EE30; 5C127/EE31; 5C127/EE32; 5C127/EE33; 5C127/EE34; 5C127/EE35; 5C127/EE36; 5C127/EE37; 5C127/EE38; 5C127/EE39; 5C127/EE40; 5C127/EE41; 5C127/EE42; 5C127/EE43; 5C127/EE44; 5C127/EE45; 5C127/EE46; 5C127/EE47; 5C127/EE48; 5C127/EE49; 5C127/EE50; 5C127/EE51; 5C127/EE52; 5C127/EE53; 5C127/EE54; 5C127/EE55; 5C127/EE56; 5C127/EE57; 5C127/EE58; 5C127/EE59; 5C127/EE60; 5C127/EE61; 5C127/EE62; 5C127/EE63; 5C127/EE64; 5C127/EE65; 5C127/EE66; 5C127/EE67; 5C127/EE68; 5C127/EE69; 5C127/EE70; 5C127/EE71; 5C127/EE72; 5C127/EE73; 5C127/EE74; 5C127/EE75; 5C127/EE76; 5C127/EE77; 5C127/EE78; 5C127/EE79; 5C127/EE80; 5C127/EE81; 5C127/EE82; 5C127/EE83; 5C127/EE84; 5C127/EE85; 5C127/EE86; 5C127/EE87; 5C127/EE88; 5C127/EE89; 5C127/EE90; 5C127/EE91; 5C127/EE92; 5C127/EE93; 5C127/EE94; 5C127/EE95; 5C127/EE96; 5C127/EE97; 5C127/EE98; 5C127/EE99; 5C127/EE00

明細書には, 日本語で要約が記載されている  
 → 機械翻訳した英文抄録が収録される

抄録  
(ABS)

AB [Machine Translation of Descriptors] The nano carbon material composite board method for manufacturing into which a nano carbon material can be patterned and can be grown up in a substrate face is provided. Plural fine particles are aligned to a substrate face, and a nano carbon material is grown up from the void between these fine particles. Since fine particles are aligned in self alignment according to a particle size when plural fine particles have been arranged to the substrate face, the nano carbon material grown-up from the void between these fine particles will be patterned in a substrate face, and will grow.

(索引は, まだ追加されていない)

2. 既存レコードに CAS スタッフが作成した抄録および索引が追加される。

- ✓ 主要特許の抄録・索引情報は発行日から 27 日以内に完成する。

AN	2011:1300575 CAPLUS				
ED	Entered STN: 13 Oct 2011				
TI	Manufacture of carbon nanomaterial composite board for electron emission element or lighting lamp				
TIJP	ナノ炭素材料複合基板製造方法およびナノ炭素材料複合基板 [原題]				
IN	Kurihara, Hitoshi; Gamo, Hidenori				
PA	Toppan Printing Co., Ltd., Japan				
SO	Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 8pp. CODEN: JKXXAF				
DT	Patent				
LA	Japanese				
CC	76-2 (Electric Phenomena) Section cross-reference(s): 57				
FAN. CNT	1				
	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 2011200939	A	20111013	JP 2010-67723	20100324
PRAI	JP 2010-67723		20100324		
CLASS					
	PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES		
	JP 2011200939	IPCI	B82B0003-00 [I, A]; C01B0001-00 [I, A]; H01J0009-02 [N, A]; H01J0063-06 [N, A]; FTERM 4G146/AA11; 4G146/AD21;		
AB	The process comprises arranging microparticles on the substrate, supporting catalyst with the substrate having arranged microparticles, and forming nano carbon material from the catalyst. Preferably, the catalyst is Co, Fe, Ni, and/or Mo; and the nano carbon material is formed by solid-liquid interface contact decomposition. The obtained composite board comprises a substrate, a plurality of microparticles arranged on the substrate, and the nano carbon material grown from the gaps between the microparticles, where the height of the nano carbon material is larger than the particle size of the microparticles (10 nm - 50 .mu.m).				
ST	carbon nanomaterial composite board electron emission element lighting lamp				
IT	Electric lamps Electron emission Nanocomposites Nanostructured materials (manufacture of carbon nanomaterial composite board for electron emission element or lighting lamp)				
IT	Decomposition (solid-liquid interface contact decomposition; manufacture of carbon nanomaterial composite board by)				
IT	7439-89-6, Iron 7439-98-7, Molybdenum 7440-02-0, Nickel 7440-48-4, Cobalt RL: CAT (Catalyst use); USES (Uses) (for manufacture of carbon nanomaterial composite board for electron emission element or lighting lamp)				
IT	7440-44-0P, Carbon RL: NANO (Nanomaterial); SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation) (manufacture of carbon nanomaterial composite board for electron emission element or lighting lamp)				
IT	9003-53-6, Polystyrene				

2011 年 11 月 1 日までに抄録・索引情報が追加された  
(抄録・索引情報が特許発行日から 20 日で完成した)

機械翻訳した英文抄録から、CAS スタッフが作成した抄録に置き換わる

抄録  
(ABS)

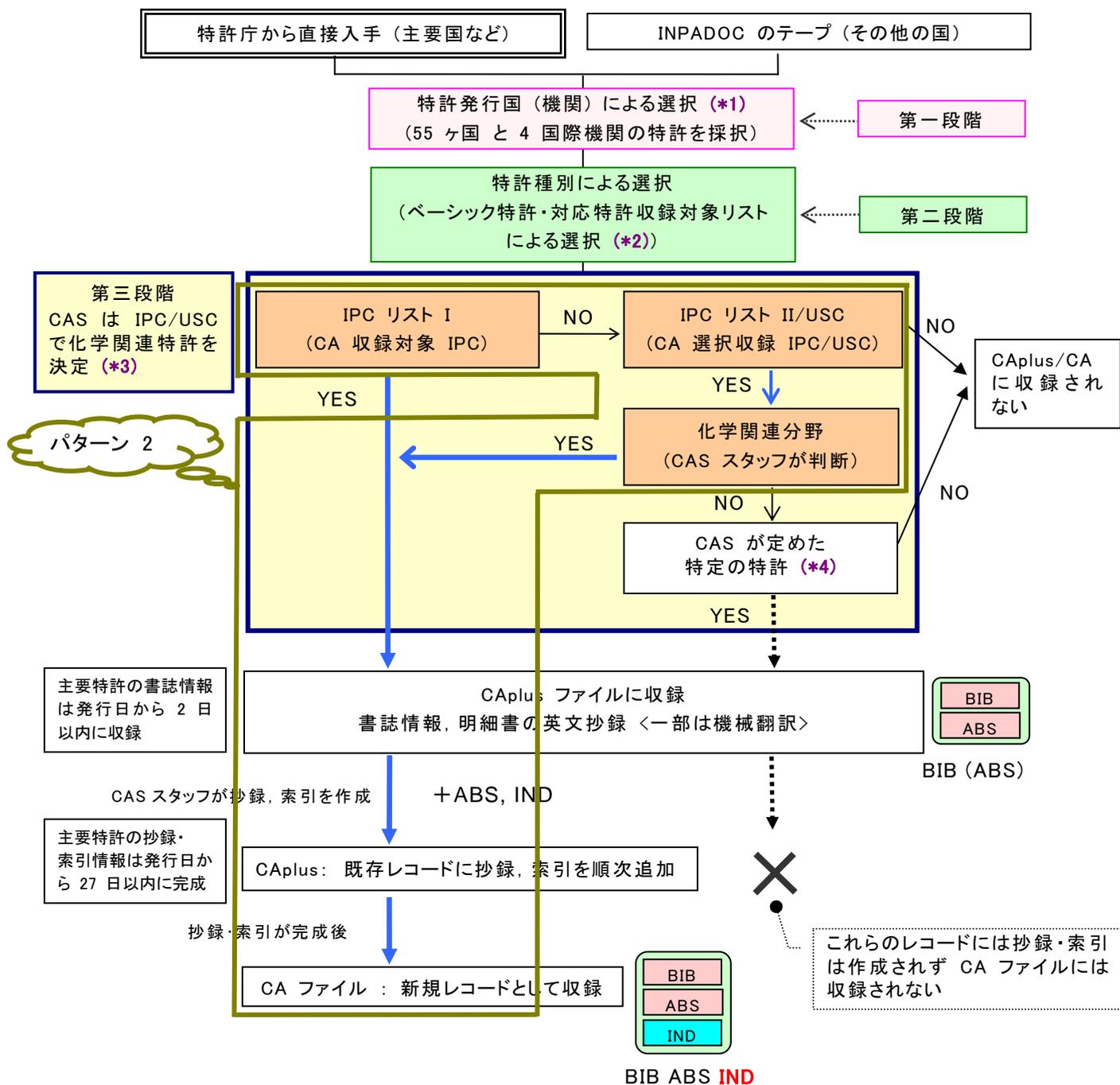
索引  
(IND)

CA ファイルに収録

- 索引が付与されたレコードは、CA ファイルにも収録される。

上記のレコードは、  
2011 年 11 月 3 日に  
CA ファイルに収録された

# 〔パターン 2：公報記載の IPC が IPC List II に含まれている化学関連分野の特許〕



## 例 : JP2011204449

JP 2011-204449 A 2011.10.13	
<div style="border: 1px solid purple; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">           第一段階 日本         </div>	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">           第二段階 公開特許         </div>
(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 公開特許公報(A)
(11) 特許出願公開番号 <b>特開2011-204449</b> (P2011-204449A)	
(43) 公開日 平成23年10月13日 (2011.10.13)	
(5) Int. Cl. HO1R 43/00 (2006.01) GO1N 27/00 (2006.01)	F I HO1R 43/00 Z GO1N 27/00 テーマコード (参考) 2G060
<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">           第三段階 特許分類により化学関連特許かどうかを決定する         </div>	
(21) 出願番号 特願2010-70217 (P2010-70217)	(71) 出願人 00000601
(22) 出願日 平成22年3月25日 (2010.3.25)	<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">           公報記載の IPC は IPC List I に含まれていなかった         </div>
	弁理士 林 久夫 (74) 代理人 10009860 弁理士 三島 清
	<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">           IPC List II に含まれているかどうかを確認する (*)         </div>
	(7) 弁理士 山東 元希 (74) 代理人 100141324 弁理士 小河 卓 (74) 代理人 100153936 弁理士 村田 健誠
最終頁に続く	
(54) 【発明の名称】 配線接続用銅合金の評価支援装置、配線接続用銅合金の評価方法、並びに、電源端子台の評価方法	

\* 米国特許の場合は、公報の IPC および USC が、IPC List II または米国特許分類リスト (<http://www.cas.org/content/references/patusnpc>) に含まれているかどうかを確認する。

IPC 8 の IPC List II (\*3)  
<http://www.cas.org/content/references/patpart8>

▶ IPC 8 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC 8 Selective Coverage  
 ▶ Country Codes and Years  
 ▶ Kind Codes  
 ▶ IPC7 Guaranteed Coverage  
 ▶ IPC7 Selective Coverage  
 ▶ U.S. NPC

For additional information, see [IPC Reform and STN](#).

**IPC Reform List II: Selective Coverage**

IPC Reform List II contains the IPC codes from the 2006 IPC Reform and subsequent updates that are selectively covered by CAS.

Patent documents from countries not listed here are automatically selected for further examination.

Patent documents with one or more of these IPC codes are automatically selected for coverage if they are issued by the following countries or patent offices:

1. AP ARIPO

G01M	Testing static or dynamic balance	3/00, 3/20-3/22, 15/00-15/05, 15/10
G01N	Analyzing materials by determining their chemical and physical properties	00/00-1/02, 1/10, 1/14-1/44, 3/28, 3/40, 3/56-3/60, 5/00-7/20, 9/00-9/06, 9/24-11/08, 11/14, 13/00-15/04, 15/06-19/04, 19/10-21/35, 21/39-21/55, 21/59-21/85, 21/88-21/89, 21/90-21/95, 21/958-22/00, 22/04-23/12, 23/20-25/58, 25/62-25/64, 25/70, 27/00-27/18, 27/22, 27/26-27/453, 27/60, 27/62-27/76, 27/92-29/036, 30/00-30/96, 33/00-33/14, 33/18-33/48, 33/554-33/559, 33/569-33/571, 33/574-33/579, 35/00-37/00
G01Q	Scanning-probe methods and apparatus; applications	all groups

G01N 27/00 は IPC List II に含まれている

H01Q	Aerials	1/00, 1/38-1/40, 15/08, 19/09
H01R	Electrically conductive connections	00/00-4/04, 4/22, 4/58-4/64, 4/68-4/72, 13/00-13/03, 13/46-13/50, 13/52, 13/527-13/533, 39/18-39/26, 39/30, 43/06, 43/10-43/12
H01S	Devices using stimulated emission	00/00-3/067, 3/08, 3/09-3/10, 3/102-3/115, 3/13-3/134, 3/14-5/00, 5/028-5/068, 5/0687-5/50

H01R 43/00 は IPC List II に含まれていない

公報記載の IPC が IPC List I に含まれていないが、一つでも、**IPC List II** に含まれている場合は、CAS のスタッフが**化学関連分野かどうか**を決定する。

- **化学関連分野の場合は、パターン 2**
  - CAplus ファイルに収録され、**必ず索引が付与**される
  - CA ファイルにも収録される
- 化学関連分野でない場合は、パターン 3

CAS のスタッフが、当該特許は化学関連分野の特許であると判断した。

人手で  
判断!



CPlus ファイルに収録

これ以降の CPlus/CA ファイルへの収録の流れは、  
パターン 1 と同じ

1. 初めに、CPlus ファイルに書誌情報、明細書の英文抄録（一部は機械翻訳）が収録される。

書誌情報 (BIB)	AN	2011:1305201	CAPLUS			
	ED	Entered STN:	14 Oct 2011			
	TI	The evaluation method of the evaluation support apparatus of the copper alloy for wiring connection, and the copper alloy for wiring connection, and the evaluation method of a power supply terminal stand [Machine Translation].				
	TIJP	配線接続用銅合金の評価支援装置、配線接続用銅合金の評価方法、並びに、電源端子台の評価方法 [原題]				
	IN	Kawai, Yasuhiko				
	PA	Mitsubishi Electric Corp., Japan				
	SO	Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 12pp. CODEN: JKXXAF				
	DT	Patent				
	LA	Japanese				
	CC	76 (Electric Phenomena)				
書誌情報 (STD)	FAN. CNT	1				
		PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO. DATE	
	PI	JP 2011204449	A	20111013	JP 2010-70217 20100325	
	PRAI	JP 2010-70217		20100325		
	CLASS					
		PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES		
		JP 2011204449	IPCI	H01R0043-00 [I, A]; G01N0027-00 [I, A]		
			FTERM	2G060/AA10; 2G060/AD04; 2G060/AE28; 2G060/AF02; 2G060/AF07; 2G060/AG01; 2G060/EA08; 2G060/EB03; 2G060/GA01; 2G060/HA01; 2G060/HC07; 2G060/HC09; 2G060/HE01; 2G060/KA14; 5E051/GB09		
	抄録 (ABS)	AB	[Machine Translation of Descriptors] The evaluation support apparatus of the copper alloy for wiring connection which supports properness evaluation of the copper alloy for wiring connection, and the copper alloy for wiring connection, and the evaluation method of a power supply terminal stand [Machine Translation].			
			state close to actual imperfect complicated apparatus By the apparatus 10 contacts the terminal material 60a and the copper wire 20, and blocks an elec. conduction near the terminal area of prescribed number of times repeating, the terminal material 60a, and the copper wire 20.			
		wiring 21, and conducts the electricity, A copper suboxide is generated for the behavior which makes non-contact the terminal material 60a and the copper wire 20, and blocks an elec. conduction near the terminal area of prescribed number of times repeating, the terminal material 60a, and the copper wire 20.				

(索引は、まだ追加されていない)

## 2. 既存レコードに CAS スタッフが作成した抄録および索引が追加される。

AN	2011:1305201 CAPLUS				
ED	Entered STN: 14 Oct 2011				
TI	Circuit interconnection copper alloy evaluation supporting apparatus and process and evaluation of power terminal tables				
TIJP	配線接続用銅合金の評価支援装置、配線接続用銅合金の評価方法、並びに、電源端子台の評価方法 [原題]				
IN	Kawai, Yasuhiko				
PA	Mitsubishi Electric Corp., Japan				
SO	Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 12pp. CODEN: JKXXAF				
DT	Patent				
LA	Japanese				
CC	76-2 (Electric Phenomena) Section cross-reference(s): 56				
FAN.CNT	1				
	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 2011204449	A	20111013	JP 2010-70217	20100325
PRAI	JP 2010-70217		20100325		
CLASS					
	PATENT NO.	CLASS	PATENT FAMILY CLASSIFIC	機械翻訳した英文抄録から、CAS スタッフが作成した抄録に置き換わる	
	JP 2011204449	IPC1	H01R0043-00 [I, A]; G01N		
		FTerm	2G060/AA10; 2G060/AD04;		
	:				
AB	The title circuit interconnection Cu alloy evaluation supporting apparatus provides a simplified support for proper evaluation of circuit interconnect Cu alloy by simulating practically imperfect connection. The evaluation supporting apparatus provides Cu suboxide formation on a terminal/Cu-wire connection proximity by impression of elec. current across between the Cu wire and the circuit terminal in repeated connection/disconnection caused by cum rotation.				
ST	copper alloy wire imperfect connection copper suboxide formation evaluation				
IT	Electric conductivity (of copper and copper suboxide; circuit interconnection copper alloy evaluation supporting apparatus and process and evaluation of power terminal tables)				
IT	Simulation and Modeling (of imperfect connection of copper wire; circuit interconnection copper alloy evaluation supporting apparatus and process and evaluation of power terminal tables)				
IT	7440-50-8, Copper 1273106-23-2, Copper alloy RL: PRP (Properties); RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent) (evaluation of imperfect connection for, apparatus for; circuit interconnection copper alloy evaluation supporting apparatus and process and evaluation of power terminal tables)				
IT	1317-39-1, Copper suboxide RL: PRP (Properties); TEM (Technical or engineered material use); USES (Uses) (formation from Cu wire, by imperfect connection, simulation of, conductivity in; circuit interconnection copper alloy evaluation supporting apparatus and process and evaluation of power terminal tables)				
IT	12597-68-1, Stainless steel 12597-71-6, Brass RL: PRP (Properties) (terminals, to be contacted by Cu wires; circuit interconnection copper				
	:				

抄録  
(ABS)索引  
(IND)

## CA ファイルに収録

- 索引が付与されたレコードは、CA ファイルにも収録される。

上記のレコードは、  
2011年11月3日に  
CA ファイルに収録された



## 例 : JP2011205944

JP 2011-205944 A 2011. 10. 20	
第一段階 日本	第二段階 公開特許
(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 公開特許公報(A)
(11) 特許出願公開番号 特開2011-205944 (P2011-205944A)	
(43) 公開日 平成23年10月20日 (2011. 10. 20)	
(51) Int. Cl. A23C 19/084 (2006.01)	F I A23C 19/084
テーマコード (参考) 4B001	
審査部	
(21) 出願番号 特願2010-76020 (P2010-76020) (22) 出願日 平成22年3月29日 (2010. 3. 29)	(71) 出願人 000006127 (74) 代理人 弁理士 志賀 隆夫 (74) 代理人 100108578 弁理士 高橋 勇 (74) 代理人 100089037 (74) 代理人 100089037 弁理士 鈴木 三義 (74) 代理人 100107836 弁理士 西 和哉 (74) 代理人 100108453 弁理士 村山 靖彦
最終頁に続く	
(54) 【発明の名称】 チーズ食品およびその製造方法	

第三段階  
特許分類により化学関連特許かどうかを決定する

↓

公報記載の IPC は IPC List I に含まれていなかった

↓

IPC List II (\*) には含まれていた

\* 米国特許の場合は、公報の IPC および USC が、IPC List II または米国特許分類のリスト (<http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/patcoverage/usnpc.html>) に含まれているかどうかを確認する。

公報記載の IPC が IPC List I に含まれていないが、一つでも、IPC List II に含まれている場合は、CAS のスタッフが**化学関連分野かどうか**を決定する。

- 化学関連分野の場合は、パターン 2
  - CAplus ファイルに収録され、必ず索引が付与される
  - CA ファイルにも収録される
- **化学関連分野でない場合は、パターン 3**

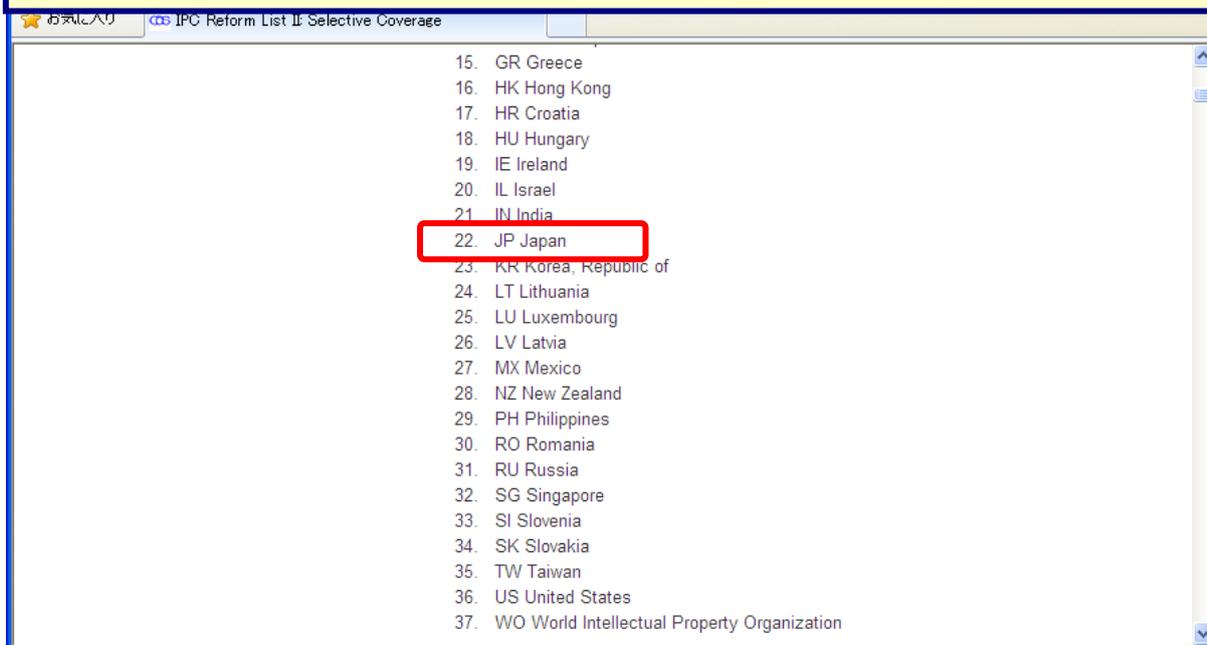
CAS のスタッフが、当該特許は化学関連分野の特許でないと判断した。

人手で  
判断!

CAS が定めた特定の特許かどうかを \*4 で確認する

#### CAS が定めた特定の特許 (\*4)

<http://www.cas.org/content/references/patpart8>



日本の特許は CAS が定めた特定の特許である。

→ CAplus ファイルに書誌情報は収録されるが、化学関連分野では無いために、

**索引は付与されない。**

→ **CA ファイルには収録されない。**

## CAplus ファイルに収録

- CAplus ファイルに書誌情報、明細書の英文抄録（一部は機械翻訳）が収録される。

**書誌情報 (BIB)**

AN 2011:1332077 CAPLUS  
 ED Entered STN: 20 Oct 2011  
 TI Cheese food and its manufacturing method [Machine Translation].  
 TIJP チーズ食品およびその製造方法 [原題]  
 IN Kitajima, Sachiko; Abe, Tadahiro; Koishihara, Hiroshi  
 PA Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Japan  
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 11pp.  
 CODEN: JKXXAF  
 DT Patent  
 LA Japanese  
 FAN. CNT 1

**書誌情報 (STD)**

PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI JP 2011205944	A	20111020	JP 2010-76020	20100329
PRAI JP 2010-76020		20100329		

CLASS  
 PATENT NO. CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES  
 JP 2011205944 IPCI A23C0019-084 [I, A] <--  
 FTERM 4B001/AC20; 4B001/AC21; 4B001/AC22; 4B001/BC01;  
 4B001/BC05; 4B001/EC99

**抄録 (ABS)**

AB [Machine Translation of Descriptors]. It is the cheese food manufactured through the process of cutting sheet-type cheese, and the method for manufacturing of cheese food which contained food grinding products and made it possible to manufacture texture of those food grinding products with poor cleavage of sheet-type cheese. The fluid mixture which is a method for manufacturing of the cheese food containing food grinding products, and contains fusion cheese and food grinding products is prepared, Pull out laminary, cooling fluid mixture and it has process (2) which forms sheet-type cheese, and the process (3) of cutting sheet-type cheese, it is the particles of .gtoreq.4 among the total particles which constitute food grinding products are 0 mass %, and a mesh value (mm) is [ <4 ] .gtoreq.50 mass %, and the method for manufacturing of the food characteristic of a mesh value (mm) .ltoreq.50 mass %.

特許発行日 (2011 年 10 月 20 日)  
 当日に書誌情報が収録された

明細書には、日本語で要約が記載されている  
 → 機械翻訳した英文抄録が収録される

パターン 3 における日本特許の  
 抄録は、今後も機械翻訳の抄録  
 のままである

パターン 3 を通り、CAplus ファイルに入った特許が化学関連分野でないと判断されたため、抄録・索引情報は作成されない。  
 よって、これ以上レコードに情報が追加されない

索引が付与されないレコードは、CA ファイルには収録されない。  
 つまり、パターン 3 のレコードは CAplus ファイルにのみ収録される